

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-010

通富微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,517,596,912 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司所处行业情况

2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，在全球经济逐步复苏与数字化转型加速的大背景下，半导体作为现代科技的核心基石，迎来了增长与变革，半导体行业在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，逐步向好。消费电子领域的回暖，使得智能手机、平板电脑等设备的出货量逐步回升，拉动半导体市场规模扩张。而人工智能领域对算力的渴求，进一步拓宽了半导体行业的发展边界，为其持续增长注入源源不断的动力。

1) 全球半导体市场周期上行

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计，2024 年全球半导体销售额达到 6,276 亿美元，相较于 2023 年的 5,268 亿美元，增长 19.1%，年销售额首次突破 6,000 亿美元大关。其中，2024 年第四季度全球半导体市场规模达到 1,709 亿美元，同比增长 17%，较第三季度环比增长 3%。世界集成电路协会（WICA）发布的报告显示，2024 年全球半导体市场规模攀升至 6,351 亿美元，同比增长 19.8%，且预计 2025 年全球半导体市场仍将保持增长，有望进一步增至 7,189 亿美元，同比增长 13.2%。

2024 年存储器、逻辑芯片、微处理器实现正增长，其中存储器产品、高性能 DRAM 产品及服务器 SSD（固态硬盘）受人工智能大模型需求刺激销量实现大幅度提升，存储器产品增长率达到 75.6%，成为半导体产品中增速最大的类别。

2024 年，全球半导体封测行业在经历了前几年的供应链波动后，逐步进入稳定增长阶段。随着人工智能、高性能计算、5G 通信、汽车电子等领域的需求驱动，封测行业作为半导体产业链的关键环节，市场规模持续扩大。根据 Gartner 于 2024 年 12 月发布的报告，2024 年全球集成电路封测市场规模预计达到 820 亿美元，同比增长 7.8%。

2025 年，人工智能大模型发展将继续发酵，持续带动高性能芯片应用，手机、电脑等消费市场有望回暖，机器人领域创新将带动其余集成电路产品的销售。市场调研机构 Counterpoint 认为，AI 芯片将成为核心战场，AI 计算需求推动 GPU 需求，预计未来几年存储芯片、数据中心、边缘计算仍将高增长。

2) 中国半导体市场展现较强的产业活力

2024 年，中国半导体行业在技术创新与政策博弈的双重作用下不断发展，展现出较强的增长韧性与产业活力。全年中国半导体销售额达 1.3 万亿元人民币，占全球市场的 30.1%，同比增长 20.1%。全年集成电路出口额达 1,595 亿美元，同比增长 17.4%，连续 14 个月保持正增长，首次超越手机成为出口额最高的单一商品，标志着我国半导体产业在全球市场的竞争力显著提升。当前，我国正处于新一轮科技革命、产业变革和产业链、供应链水平提升的关键时期，网络化、数字化、智能化发展迅猛，不依赖于尺寸微缩的多种新路径，日益成为集成电路发展的新动力，为集成电路发展带来新市场和新空间。据中国半导体行业协会设计分会理事长魏少军预测，到 2025 年中国大陆半导体芯片市场规模将达到 2,230 亿美元，相较于 2024 年增长约 20%。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示：“全球半导体行业迎来强劲复苏，这主要基于新兴技术的快速发展和市场需求的回升。在我国广阔的消费电子市场和汽车电子市场引领下，

国内半导体企业迎来前所未有的发展机遇。”人工智能、5G 通信及物联网等新兴领域的技术迭代成为核心增长引擎。与此同时，AI 芯片市场规模爆发式增长，年复合增长率超 40%，带动算力需求激增，推动国内企业在先进制程工艺上突破。

3) 人工智能行业高歌猛进，AI 终端渗透率加快提升

在算力投资持续推进下，全球各大厂商加大对 AI Agent 等大模型驱动的人工智能应用投入，有望推动 AI 终端市场的繁荣。IDC 预计 2024 年全球人工智能资本开支达 2,350 亿美元，并预计 2028 年增长至 6,320 亿美元，复合增速达 29%。AI Agent 是以 AI 大模型为驱动的 AI 终端应用，有望推动大模型的商业化应用，加速“AI+”产业发展。根据 IDC 数据，AI 手机在 2024-2027 年将由 0.4 亿台增长至 1.5 亿台，渗透率由 13.2%提升至 51.9%。以手机为代表的 AI 终端出货量加快增长，带给上游供应链市场扩容机遇。除此之外，AI 眼镜也是终端运用的创新成果之一，其具有佩戴方便，交互自然等优势，功能涵盖耳机、相机、太阳镜、近视镜，可实现翻译、识别物体、问答、智能助手，被称为是 AI 端侧落地最佳载体，从硬件制造（芯片、光学器件、传感器）到软件应用（AI 算法、AR 交互），中国 AI 眼镜产业链已形成完整的产业生态。

4) 政策组合拳强化产业韧性

2024 年，全球半导体产业面临地缘政治博弈与技术迭代的双重冲击，我国已系统性布局构建产业护城河，国家及地方政府出台了一系列支持半导体产业发展的政策。

2024 年 1 月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，旨在推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，并加快超导材料等前沿新材料创新应用。

2024 年 5 月，国家集成电路产业投资基金三期注册成立，注册资本达 3440 亿元，超过前两期大基金总和，预计会赋能半导体制造、先进封装、设备、材料等关键领域，加快国内先进芯片制造领域突破卡脖子的进程。

2024 年 6 月，国家发布《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》，鼓励首台（套）重大技术装备、首批次新材料创新发展，有助于半导体行业的关键设备和材料实现国产化替代。

2024 年 12 月，财政部发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，提出在政府采购活动中给予本国产品 20%的价格评审优惠。该政策将帮助国产芯片在政府采购中的市占率显著提升，推动国产半导体设备、CPU、GPU 等性价比提升，加速国产替代进程。

上述这些政策的出台为中国半导体产业的发展提供了有力的支持和保障。

(2) 报告期内公司从事的主要业务

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。2024 年，半导体市场瞬息万变，公司坚定不移办好自己的事，用自身的确定性来应对外部的不确定性。

2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂

不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、营运及人才融合等方面收获良好的效益；集团内其他工厂不断完善运行机制，提升质量水平，推动人才梯队建设，狠抓降本工作，倾力打造核心竞争力。2024 年，公司实现营业收入 238.82 亿元，同比增长 7.24%。根据芯思想研究院发布的 2024 年全球委外封测榜单，公司在全球前十大封测企业中排名不变。

2024 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 6.78 亿元，同比增长 299.90%。2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，在行业去库存逐步到位，数据中心、汽车电子等行业需求拉动以及消费电子产品政策利好的共同作用下，市场需求逐渐回暖。同时，人工智能在 PC 端的蓬勃发展有望带动半导体行业进一步向上增长。报告期内，得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，公司市场开拓卓有成效，产品结构得以进一步优化，产能利用率提升，营业收入增长，特别是中高端产品营业收入增加明显。同时，通过加强管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升，全方位推动公司高质量发展。

2024 年，全体通富人在市场浪潮中锚定方向，以水滴石穿的定力持续深耕，用破茧成蝶的勇气突破桎梏。梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。挑战与机遇总是并存，我们从来都是在风雨洗礼中发展壮大。只要我们坚定“一条心”，拧成“一股绳”，形成高质量发展的“通富合力”，我们必将在时代浪潮中破浪前行，不断开创高质量发展新局面！

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	39,340,187,388.18	34,877,709,853.20	12.79%	35,635,274,453.07
归属于上市公司股东的净资产	14,690,833,021.88	13,917,141,774.57	5.56%	13,831,616,796.43
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	23,881,680,710.28	22,269,283,210.86	7.24%	21,428,576,599.20
归属于上市公司股东的净利润	677,588,312.75	169,438,510.85	299.90%	501,832,456.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	621,087,213.82	59,483,489.23	944.13%	356,428,801.06
经营活动产生的现金流量净额	3,877,209,658.23	4,292,652,175.28	-9.68%	3,197,950,182.76
基本每股收益（元/股）	0.45	0.11	309.09%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.11	309.09%	0.37
加权平均净资产收益率	4.75%	1.22%	3.53%	4.50%

注：2024 年公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 48.15 亿元，同比增长 9.38%。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,282,023,999.11	5,798,062,983.85	6,001,193,345.64	6,800,400,381.68
归属于上市公司股东的净利润	98,492,388.55	224,170,900.62	229,851,814.45	125,073,209.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,523,322.80	221,955,093.13	224,956,802.54	79,651,995.35
经营活动产生的现金流量净额	790,288,598.98	1,054,167,053.92	1,232,858,152.67	799,895,852.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	329,623	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	295,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	19.90%	301,941,893	301,941,893	质押	44,510,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.36%	142,008,178	142,008,178	不适用	0	
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	2.95%	44,772,619	44,772,619	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	24,099,387	24,099,387	不适用	0	
华芯投资管理有限责任公司	其他	1.35%	20,519,835	20,519,835	不适用	0	

—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司						
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.32%	20,073,036	20,073,036	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	15,275,477	15,275,477	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	11,933,241	11,933,241	不适用	0
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	7,491,860	7,491,860	不适用	0
江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙）—米利都新动力私募证券投资基金	其他	0.28%	4,199,610	4,199,610	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第10大股东江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙）—米利都新动力私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,199,610股公司股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

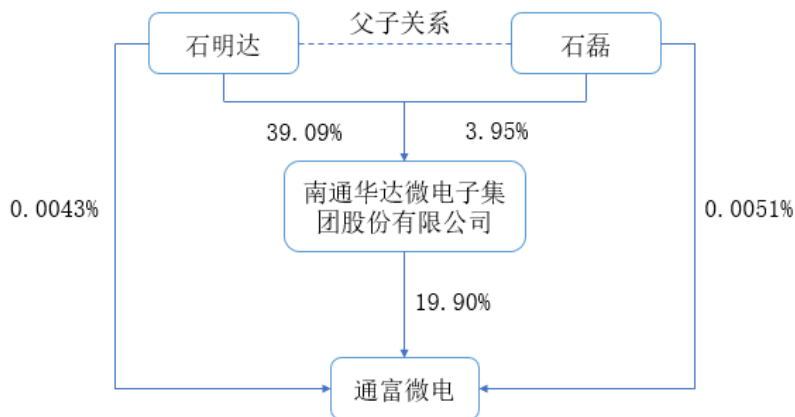
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无

通富微电子股份有限公司

董事长：石磊

2025 年 4 月 10 日